

PRÉSERVER
SAUVEGARDER
VALORISER

PROCESSEUR À MODULE DE DISSIPATION THERMIQUE

FICHE N° 4738

Période de fabrication : 1975-1999

Fabricant : International Business Machines Corp.

Domaines : Informatique et Communication

Sous-domaines : Ordinateurs

Organisme : Université de Lille

Ville : Villeneuve-d'Ascq

Modèle : 3090

Matériaux :

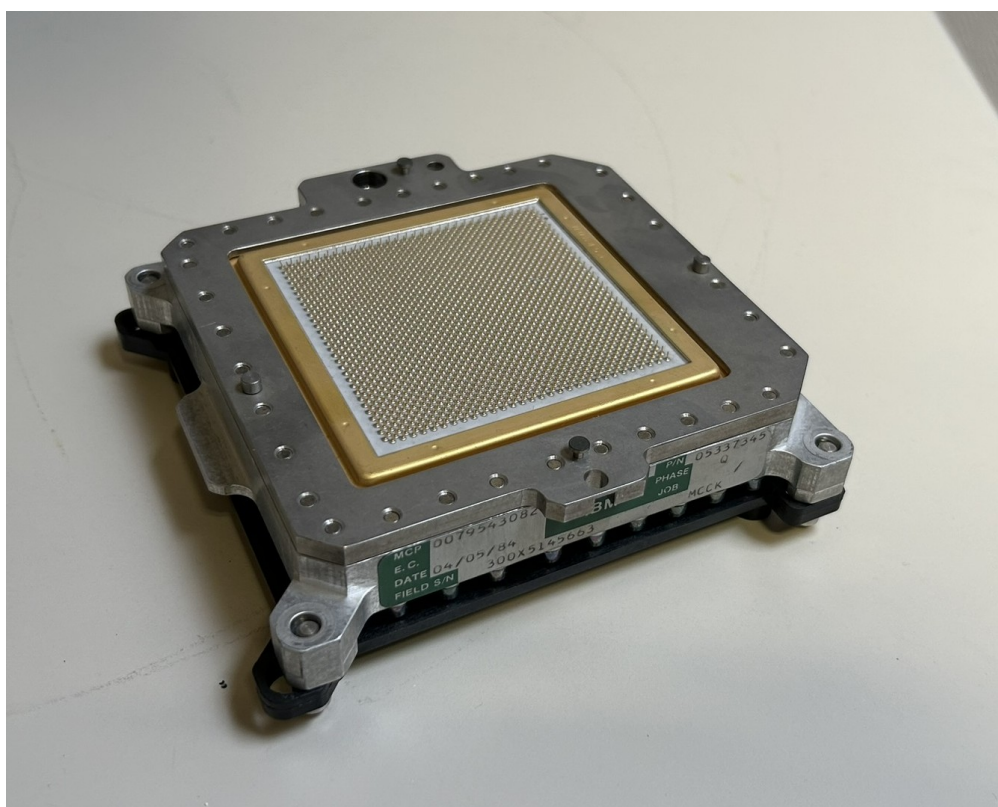
Description

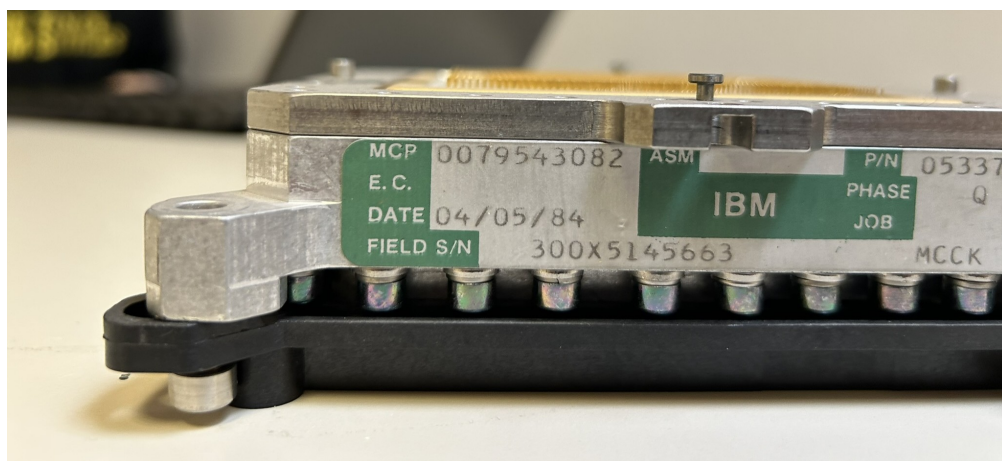
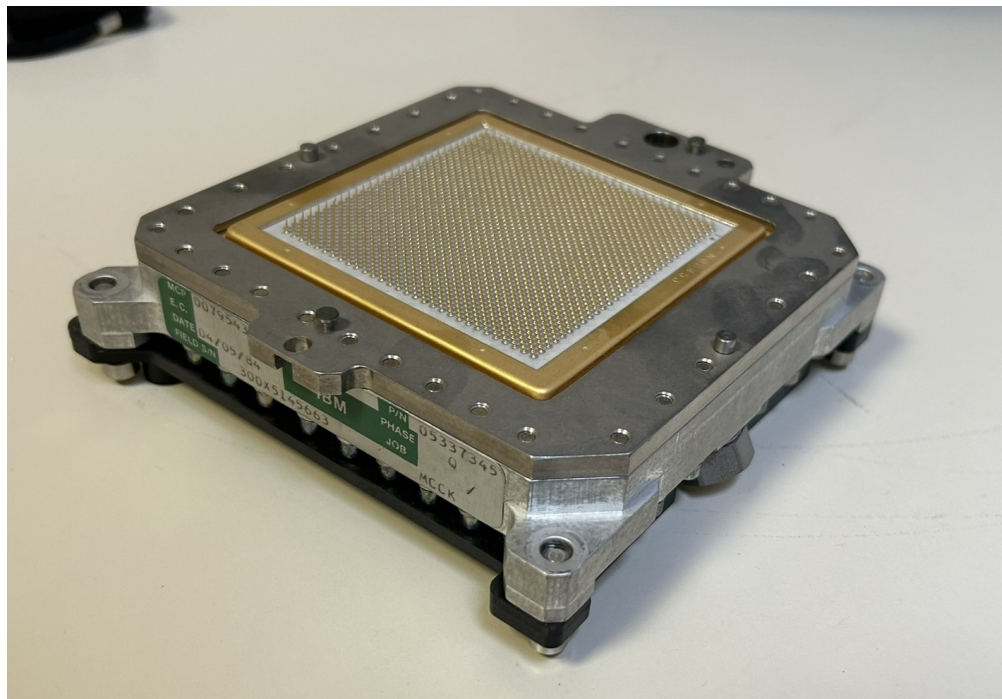
Ce processeur à module de dissipation thermique, fabriqué par IBM, a la forme d'un module métallique carré. Sa face supérieure intègre une grille régulière de microcontacts en alliage conducteur, entourée d'un cadre doré, au sein d'une ouverture délimitée par un cadre métallique comportant une série de rivetages alignés le long de ses côtés. Sa face inférieure est composée d'une plaque métallique, perforée de neuf orifices, prenant place dans un cadre de plastique noir. L'un de ses côtés est ouvert en son centre et reçoit une vis à tête hexagonale. Le module est cantonné, à ses angles, d'un système de verrouillage permettant aux deux parties du module de rester solidaires.

Un processeur à module de dissipation thermique sert à exécuter les tâches et instructions d'un ordinateur, à traiter les données transmises et à évacuer la chaleur produite par le processeur. Pour ce faire, ce module doit être au préalable inséré dans un ordinateur personnel de marque IBM et de type mainframe 3082. L'ordinateur peut ensuite alimenter en électricité le module et l'exploiter pour exécuter les tâches demandées par l'utilisateur, grâce à une interface propriétaire IBM. Le module de dissipation thermique en métal assure la fixation du processeur et l'évacuation de la chaleur, grâce à la conduction thermique.

Utilisation

Cet appareil a été utilisé par les services informatiques de l'Université de Lille, vraisemblablement par le Centre interuniversitaire de traitement de l'information (CITI) dans le cadre d'un appui administratif, à la pédagogie et/ou à la recherche.





Pour nous citer :

Base de la Mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain, PATSTEC, Processeur à module de dissipation thermique (International Business Machines Corp.), <https://www.patstec.fr/ressources/objets/detail?id=31960>, consulté le 2026-10-20